

コンデンサ; 電解型のコンデンサ, 整流器, 検波器, 開閉装置, 感光装置また感温装置 (誘電体としての特定の材料の選択 H01B3/00; 電位障壁を有するコンデンサ H01L29/00)

注

このサブクラスにおいては, グループ H01G11/00 はグループ H01G4/00 および H01G9/00 に優先する。[2013. 01]

サブクラス内の索引

コンデンサ.....
 固定コンデンサ 4/00.....
 可変コンデンサ: 機械的手段によるもの; 非機械的手段によるもの 5/00, 7/00.....
 ハイブリッド 11/00.....
 細部 2/00.....
 電解型装置 9/00.....
 構造的組み合わせ 15/00, 17/00.....
 製造 4/00, 5/00, 7/00, 9/00, 13/00.....
 2/00 グループ H01G4/00-H01G11/00 のうちの 1 つのグループにも包含されないコンデンサの細部 [6]
 101 ・コンデンサの電気的特性を修正または補償するための回路 (インピーダンス回路網 H03H)
 2/02 ・取り付け [6]
 101 ・・ 取付機構を有するもの
 101 A 取付けバンドを用いたもの
 101 B 取付け容器を用いたもの
 101 C 取付け具を用いたもの (H01G2/02 101A, B 優先)
 101 D コンデンサ素子収納ケース自体に取付け部を形成したもの
 101 E 複数のコンデンサの取付け, 例. アレイまたはモジュール
 101 Z その他のもの
 2/04 ・・ 特にシャーシーへの取り付けに適合するもの [6]
 2/06 ・・ 特に印刷回路基板への取り付けに適合するもの [6]
 A リード型素子を取付けるもの
 B ・ リードに加工を施したもの
 C 印刷回路基板自体に特徴を有するもの
 Z その他のもの
 500 ・・・ 表面実装, 例. チップコンデンサ
 501 ・・・・ 素子自体を印刷回路基板の孔に取付けるもの
 2/08 ・ 冷却装置; 加熱装置; 通気装置 [6]
 A 放熱または冷却に関するもの
 B 油量調整に関するもの
 Z その他のもの
 2/10 ・ 容器; 外装 [2006. 01]
 A 電力用コンデンサ

B 締付
 C 容器
 D ・ 筒状容器
 E ・ 油入容器
 J 被覆
 K ・ モールド
 Q ・・ 浸漬によるもの, 例. ディッピング
 R ・・ 型でモールドするもの
 L ・ 被覆筒体の封口
 M カバー, 保護ケース
 P 固体コンデンサ以外の形式のコンデンサにも適用されるもの
 Z その他のもの (チップ枠 H01G2/06)
 300 ・・ 封止, 例. リード線; 蓋
 301 ・・・ 封口
 600 ・・ 容器内でのコンデンサの固着
 2/12 ・ 腐食に対する保護 (H01G2/10 が優先) [6]
 2/14 ・ 電氣的または熱的過負荷に対する保護 (冷却によるもの H01G2/08) [6]
 101 ・・ 電氣的過負荷に対する保護
 101 A 放圧を行うもの
 101 Z その他のもの
 103 ・・・ コンデンサと並列に放電間隙が組み込まれたもの
 104 ・・・ 物理的または化学的に異常を検知する手段が組み込まれたもの
 105 ・・・・ 異常電流を検知する手段が組み込まれたもの
 105 D 伝達手段に特徴を有するもの
 105 Z その他のもの
 106 ・・・・ 異常温度を検知する手段が組み込まれたもの
 107 ・・・・ 発生するガスを検知する手段が組み込まれたもの
 108 ・・・ コンデンサが容器内で直接樹脂充填されたもの
 108 B 異常電流を検知するもの
 108 C 異常温度を検知するもの
 108 D 放圧構造を有するもの
 108 Z その他のもの
 2/16 ・・ ヒューズ素子を有するもの [6]
 101 ・・・ 強制短絡を行うもの
 201 ・・・ 遮断警報を有するもの
 301 ・・・ 温度ヒューズを有するもの
 2/18 ・・ 遮断可能な接点を有するもの [6]
 101 ・・・ スイッチを用いるもの
 2/20 ・ 電極の端部から放電を防ぐための装置 [6]
 2/22 ・ 静電遮蔽または磁気遮蔽 [6]
 2/24 ・ 表示マーク, 例. カラーコード [6]
 4/00 固定コンデンサ; その製造方法 (電解コンデンサ H01G9/00) [2]
 A 製造方法
 B 構造

H 0 1 G

Z	その他のもの
4/002	・細部[6]
4/005	・電極[6]
4/008	・材料の選択[6]
500	・焼成電極
4/01	・自己支持電極型[6]
4/012	・非自己支持電極型[6]
4/015	・自己回復型[6]
4/018	・誘電体[6]
4/02	・気体または蒸気誘電体[2, 6]
4/04	・液体誘電体[2, 6]
4/06	・固体誘電体[2, 6]
4/08	・無機誘電体[2, 6]
A	マイカを用いるもの
C	蒸着によるもの
Z	その他のもの
4/10	・金属酸化物誘電体[2, 6]
500	・ガラスを用いるもの
4/12	・セラミック誘電体[2, 6]
090	・セラミック誘電体材料で特徴付けられるもの (H01G4/12 720, H01G4/12 810 が優先)
180	・酸化チタンまたはチタン酸塩を基とするもの (H01G4/12 450 が優先)
270	・アルカリ土類のチタン酸塩を基とするもの
360	・酸化ジルコニウムまたはジルコニウム酸塩を基とするもの (H01G4/12 630 が優先)
450	・チタン酸塩も含むもの
540	・ニオブまたはタングステン、酸化タンタルまたはニオブ酸塩、タンタル酸塩を基とするもの
630	・酸化ジルコニウムまたはジルコン酸塩も含むもの
720	・半導体性セラミックコンデンサ
810	・粒界層を有するもの
900	・ガラス相を含むもの, 例. ガラスセラミック
4/14	・有機誘電体[2, 6]
500	・蒸着によるもの
4/16	・繊維性材料によるもの, 例. 紙[2, 6]
4/18	・合成物質によるもの, 例. 繊維素の派生物 (H01G4/16 が優先) [2, 6]
300	・繊維素の派生物 (H01G4/14 500 が優先)
600	・ハロゲン化物 (H01G4/14 500 が優先)
4/20	・グループ H01G4/02-H01G4/06 までの二つ以上からの誘電体の組み合わせを用いるもの (H01G4/12 が優先) [2, 6]
300	・繊維性材料または合成物質

600	・無機および合成材料
4/22	・含浸したもの[2, 6]
100	・含浸物の組成に特徴を有するもの
200	・ハロゲン化物
4/224	・容器; 外装[2006. 01]
100	・セラミックコンデンサの外装
200	・フィルムコンデンサの容器
4/228	・端子部[6]
A	基板への取付部の構造に特徴を有するもの
B	電極への接続部の構造に特徴を有するもの
E	リードフレームまたはチェーンリード構体
F	リードの材料または断面構造に特徴を有するもの
G	シャーシ, その他の装置への取付に特徴を有するもの
H	モールド, その他の装置への取付に特徴を有するもの
J	複数の部品の接続に関するもの
K	特殊なコンデンサの端子, 例. 貫通型, 厚膜, 薄膜コンデンサ等の端子
L	有機誘電体を用いるコンデンサの端子
M	・巻芯または巻芯の閉塞
Q	・樹脂注入封止型またはモールド型のコンデンサの端子
R	・保護装置に関連するもの
S	・複数の素子の接続に関するもの
T	・チップ化
W	リードを有するチップ型
Z	その他のもの
4/232	・積層型または巻回型コンデンサーの二つ以上の層を電氣的に接続するもの[6]
A	無機誘電体を有するもの
B	端子の材料に特徴を有するもの
E	電極と端子を機械的に接続または溶接, 半田により接続するもの
Z	その他のもの
4/236	・容器を通しリードを引出すもの, すなわち, リードスルー[6]
4/242	・端子部を取り囲むコンデンサ素子[6]
4/245	・巻回型電極の層間のタブ[6]
4/248	・コンデンサ素子を包含または取り囲む端子部, 例. キャップ (H01G4/252 が優先) [6]
4/252	・コンデンサ素子に被覆される端子部 (H01G4/232 が優先) [6]
B	メタリコン, 導電性塗料, 半田または蒸着に関するもの
C	・メタリコン, 導電性塗料, 半田または蒸着の構造または材料に特徴を有するもの
D	・メタリコン, 導電性塗料, 半田または蒸着による端子の接続に特徴を有するもの

V	リードレスチップ型	520	・・・筒状型, 壺型または柱状回
Z	その他のもの	530	・・・巻回型
4/255	・・・容量値補正手段[6]	540	・・・基板印刷型, 例. 厚膜または薄膜コンデンサ
4/258	・・・温度補償手段[6]	541	・・・構造
4/26	・・・折り重ね型コンデンサ[2]	544	・・・材料
4/28	・・・チューブラコンデンサ[2]	547	・・・製法
4/30	・・・積層型コンデンサ (H01G4/33が優先)[2, 6]	550	・・・貫通型
120	・・・セラミック体中に形成した空洞に金属を注入して得られたもの	560	・・・一般磁器コンデンサ, 例. 板状またはU字型コンデンサ
140	・・・他のコンデンサから得られたもの	4/32	・・・巻回したコンデンサ[2]
160	・・・薄膜技術により作られたもの	301	・・・構造
180	・・・転写技術により作られたもの	301	Aフィルムの組合せまたは配置
201	・・・構造または材料	301	Bフィルム自体の構造
201	A積層構造	301	C安全装置付のもの
201	B内部電極	301	D冷却パイプ付のもの
201	C・内部電極の構造	301	Eチップ型
201	D・内部電極の材料	301	F外装または容器
201	E外部電極	301	Zその他のもの
201	F・外部電極の構造	305	・・・リードおよびリード引出し部
201	G・外部電極の材料	305	Aリード
201	H・外部電極に接続するリード	305	B端面電極, 例. メタリコン電極等
201	J誘電体	305	Zその他のもの
201	K・誘電体の構造	311	・・・製造方法
201	L・誘電体の材料	311	A巻き方
201	M・素子主面の誘電体に特徴を有するもの	311	Zその他のもの
201	N・素子側面の誘電体に特徴を有するもの	500	・・・フィルムコンデンサ
201	Pチップ型	510	・・・フィルムコンデンサの構造または材料
201	Q同軸型	511	・・・金属化フィルムの構造または材料
201	R直列接続型	511	A容量形成電極の構造
201	S安全装置付のもの	511	D容量形成電極の材料
201	Zその他のもの	511	G誘電体フィルムの構造
311	・・・製造方法	511	H・粉末または粒子を混入したもの
311	A切断の仕方	511	J・網目要素をもつもの
311	B・ドラムに巻いて切断する方法	511	K・粗面化したもの
311	C・巻回後, 押しつぶして切断する方法	511	L誘電体フィルムの材料
311	D内部電極の製造方法	511	P金属化フィルム間に絶縁材を有するもの
311	E外部電極の製造方法	511	Zその他のもの
311	F積層の仕方	521	・・・非金属化フィルムの構造または材料
311	Zその他のもの	521	A電極箔
500	・・・セラミックコンデンサ	521	G誘電体フィルム
501	・・・半導体磁器コンデンサ	521	H・電荷移動型錯体を有するもの
504	・・・粒界絶縁型かつ還元再酸化型	521	J・複雑塩
506	・・・粒界絶縁型	521	K・単純塩
508	・・・還元再酸化型	521	L・不織布のもの
510	・・・積層セラミックコンデンサ (H01G4/30 501が優先)	521	P電極箔と誘電体フィルムの組合せまたは配設
511	・・・構造	521	Q電極箔と誘電体フィルムの接着
512	・・・誘電体	521	Zその他のもの
513	・・・内部電極または外部電極	530	・・・端面電極の構造, 例. メタリコン電極の構造
514	・・・材料		
515	・・・誘電体		
516	・・・内部電極または外部電極		
517	・・・製法		

- 531 端面電極に接続されるリード
- 540 外装, モールド, 容器またはガス封入
- 541 含浸したもの
- 542 チップ型
- 543 直列接続型
- 544 安全装置付のもの, 例. ヒューズ電極
- 550 フィルムコンデンサの製造方法
- 551 金属化フィルムの製造方法
- 551 A容量形成電極の製造方法, 例. 蒸着方法
- 551 B誘電体フィルムの製造方法
- 551 Zその他のもの
- 561 非金属化フィルムの製造方法
- 561 A電極箔の製造方法
- 561 B誘電体フィルムの製造方法
- 561 C・照射処理によるもの, 例. 光照射, 電子線照射等
- 561 D・放電処理によるもの
- 561 Zその他のもの
- 571 熱処理
- 572 圧縮または加工
- 573 切断
- 574 複数工程の処理
- 4/33 . 薄膜または厚膜コンデンサ[6]
- 101 . 厚膜コンデンサ, 例. 誘電体が塗布または印刷等により形成されたコンデンサ
- 102 . 薄膜コンデンサ, 例. 誘電体が蒸着または陽極酸化等により形成されたコンデンサ
- 4/35 . 貫通型コンデンサまたは雑音防止コンデンサ[6]
- 301 . 円筒型
- 311 . 巻回型
- 321 . 同軸型
- 331 . 多層型
- 341 . 複合型
- 4/38 . 複合コンデンサ, すなわち複数個の固定コンデンサの構造的組合わせ[2]
- A 固定コンデンサ同士のみで構成されるもの
- B 単一構造体の複合コンデンサ
- Z その他のもの
- 4/40 . このサブクラスに包含されない他の電気素子を有する固定コンデンサの構造的組合わせであって, その構造が, 主としてコンデンサからなるもの, 例. コンデンサおよび抵抗複合部品[2]
- A 固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの
- Z その他のもの
- 301 . 抵抗素子と結合したもの
- 301 A固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの
- 301 Zその他のもの
- 304 . . . 電圧非直線抵抗素子と結合したもの
- 304 A固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの
- 304 Zその他のもの
- 307 . . . 被着抵抗と結合したもの
- 307 A固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの
- 307 Zその他のもの
- 310 . . . 過電圧保護をなすもの
- 310 A固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの
- 310 Zその他のもの
- 313 . . . 放電ギャップまたは放電抵抗を有するもの
- 313 A固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの
- 313 Zその他のもの
- 321 . . インダクタンス素子と結合したもの
- 321 A固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの
- 321 Zその他のもの
- 5/00 機械的手段によって容量を変えるコンデンサ, 例. 軸の回転によるもの; その製造方法[2]
- 5/01 . 細部
- B 伝導機構に特徴を有するもの
- C 回転軸に特徴を有するもの
- D 取付けに特徴を有するもの
- E アースに特徴を有するもの
- F シールドに特徴を有するもの
- G 端子に特徴を有するもの
- H 振動防止に特徴を有するもの
- J 基板に特徴を有するもの
- Z その他
- 5/011 . 電極[6]
- 5/012 . . 電極の少なくとも一つが, 置換しうる液体または粉体であるもの[6]
- 5/013 . 誘電体[6]
- 100 . . 誘電体として空気, ガスまたは真空を用いるもの (液体または固体誘電体の置換を用いるもの H01G5/013, 200-H01G5/013, 390)
- 200 . . . 液体誘電体を用いるもの
- 300 . . . 固体誘電体を用いるもの
- 310 可動電極型
- 315 誘電体の材料がプラスチックであるもの
- 316 プラスチック材料に特徴を有するもの
- 320 誘電体の材料が酸化物であるもの
- 321 誘電体の材料がガラスである

	もの		
325	・ ・ ・ ・ ・ 回転無軸型	7/02	・ エレクトレット, すなわち永久双極子を有するもの
330	・ ・ ・ ・ ・ 筒型	A	組成に特徴を有するもの
335	・ ・ ・ ・ ・ スライド型	B	複層のもの
340	・ ・ ・ ・ ・ 多連のもの	C	・ 金属層を有するもの
345	・ ・ ・ ・ ・ 製造方法に特徴を有するもの	D	形に特徴を有するもの
350	・ ・ ・ ・ ・ 極板に特徴を有するもの	E	製造方法に特徴を有するもの
351	・ ・ ・ ・ ・ 固定電極に特徴を有するもの	F	・ フツ素を含むもの
352	・ ・ ・ ・ ・ 移動電極に特徴を有するもの	G	・ ・ フツ化ビニリデン
355	・ ・ ・ ・ ・ 押圧部材に特徴を有するもの	H	・ 繊維状のもの
360	・ ・ ・ ・ ・ 取付けに特徴を有するもの	Z	その他のもの
365	・ ・ ・ ・ ・ 端子に特徴を有するもの	7/04	・ 与えられる温度によって誘電率が変化するよう選択された誘電体をもつもの
370	・ ・ ・ ・ ・ 回転軸に特徴を有するもの	7/06	・ 与えられる電圧によって誘電率が変化するよう選択された誘電体をもつもの, すなわち強誘電性コンデンサ (エレクトレット H01G7/02)
375	・ ・ ・ ・ ・ 基板に特徴を有するもの	9/00	電解型コンデンサ, 整流器, 検波器, 開閉装置, 感光装置または感温装置; その製造方法[2]
380	・ ・ ・ ・ ・ 電極の有効面積の変化によるもの	030	・ 電氣的または熱的過負荷に対する保護; 冷却によるもの; 陰極膜の形成を避ける手段
381	・ ・ ・ ・ ・ 平らなまたは実質的に平らな電極を回転するもの	290	・ 製造方法に特徴を有するもの
385	・ ・ ・ ・ ・ 電極の間隙変化によるもの	290 A	誘電体層の形成
390	・ ・ ・ ・ 可動誘電体型	290 B	・ 再化成, エージングに特徴を有するもの
5/014	・ ・ 容器; 外装[2006. 01]	290 C	隔膜, 隔離体, 電解液または吸収体の製造方法
5/015	・ ・ 集電子	290 D	電極の製造方法
5/017	・ ・ 温度補償[6]	290 E	固体電解コンデンサの製造方法
5/019	・ ・ 容量特性補正手段[6]	290 F	・ 固体電解質層の形成
5/04	・ 電極の有効面積の変化を利用するもの[6]	290 G	・ ・ TCNQ を用いたものの製造方法
5/06	・ ・ 平らなまたは実質的に平らな電極の回転によるもの[6]	290 H	・ ・ 導電性高分子を用いたものの製造方法
B	伝導機構に特徴を有するもの	290 J	容器への取付の製造方法
C	回転軸に特徴を有するもの	290 K	容器の製造方法
K	容器に特徴を有するもの	290 L	封止の製造方法
L	極板に特徴を有するもの	290 M	膨張に対する弁その他の手段の製造方法
M	・ 固定電極に特徴を有するもの	290 N	電解コンデンサの電気材特性の修正または補償用回路の製造方法
N	・ 移動電極に特徴を有するもの	290 Z	その他のもの
P	押圧部材に特徴を有するもの	9/004	・ 細部[6]
Q	補助コンデンサに特徴を有するもの	9/008	・ ・ 端子[6]
Z	その他	301	・ ・ ・ 封口板に取付けられた接続端子
5/08	・ ・ ・ 連続して可変とするもの[6]	303	・ ・ ・ リードと電極箔との接続部に特徴を有するもの
5/10	・ ・ 螺旋電極の回転によるもの[6]	305	・ ・ ・ 陰極端子
5/12	・ ・ 円筒状, 円すい状または球状電極の回転によるもの[6]	9/012	・ ・ ・ 特に固体コンデンサに適合するもの[6]
5/14	・ ・ 電極の長手方向への移動によるもの[6]	301	・ ・ ・ 陰極端子またはリードに特徴を有するもの
5/16	・ 電極の間隙変化を利用するもの[6]	303	・ ・ ・ 陽極端子またはリードに特徴を有するもの
5/18	・ ・ 傾きの変化によるもの, 例. 可撓性または螺旋重ねによるもの[6]	305	・ ・ ・ チップ型素子に用いられるもの
5/38	・ 複合コンデンサ, 例. ガング		
5/40	・ このサブクラスに包含されない他の電気素子を有する可変コンデンサの構造的組合せであって, その構造が主としてコンデンサからなるもの, 例. RC 組合せ[6]		
7/00	機械的でない手段によって容量を変えるコンデンサ; その製造方法[2]		
A	湿度センサー		
Z	その他のもの		

307 ・・・・リードフレームまたはチェーンリ
ード構体

309 ・・・・その他のもの

9/02 ・・・・隔膜;セパレータ[6]

9/022 ・・・・電解質;吸収体[6]

9/025 ・・・・固体電解質 (H01G11/54 が優先) [6]

9/028 ・・・・有機半導体電解質, 例. TCNQ[6]

A TCNQ に用いたもの

B ・構造

C ・材料

E 導電性高分子に用いたもの

F ・構造

G ・材料

Z その他のもの

9/032 ・・・・無機半導体電解質, 例. 二酸化マン
ガン[6]

9/035 ・・・・液体電解質, 例. 含浸物質 (H01G11/54
が優先) [6]

9/04 ・・・・電極[6]

9/042 ・・・・材料に特徴を有するもの (H01G11/22
が優先) [6]

500 ・・・・陰極に用いられるもの

9/045 ・・・・アルミニウムを基礎とするもの[6]

9/048 ・・・・構造に特徴を有するもの (H01G11/22
が優先) [6]

A 素子の全体構造に特徴を有するもの

B ・巻回型

C ・巻芯または素子周囲, 例. 巻止めテープ

D ・端子の取付位置または電極箔の位置関
係

E ・複数の素子の組合せ

F ・積層型

G 電極箔一般

H チップ化

Z その他のもの

9/052 ・・・・焼結電極[6]

500 ・・・・粉末によるもの

503 ・・・・非焼結電極

505 ・・・・特に固体コンデンサに適合する
もの

507 ・・・・特に液体コンデンサに適合する
もの

509 ・・・・陽極箔

9/055 ・・・・エッチングした箔電極[6]

100 ・・・・陰極

103 ・・・・固体コンデンサに適合する陰
極, 例. カーボングラファイト層, 銀ペー
スト層または半田層

105 ・・・・液体コンデンサに適合する陰
極

107 ・・・・陰極ケース

9/06 ・・・・容器への取付構造[6]

A 充填剤材料に特徴を有するもの

Z その他のもの

9/07 ・・・・誘電体層[6]

9/08 ・・・・容器;外装[2006. 01]

A 被覆

B ・フィルム, シート, チューブまたはスリー
ブに関するもの

C ・モールド, ディップに関するもの

D ケース, 例. 二重容器

E ・絶縁材料からなるケースに関するもの

F ・金属ケースに関するもの

Z その他のもの

9/10 ・・・・封止, 例. リード線の[6]

A ハーメチックシール

C 封口体と端子またはリードとの封止に特徴
を有するもの

D 封口体とケース端部との封止に特徴を有す
るもの

E 封口体材料に特徴を有するもの

F ・多層構造

G チップ型素子に用いられるもの

Z その他のもの

9/12 ・・・・膨張に対する弁その他の手段[6]

A 封口体に溝, 肉薄部分または防爆孔を有す
るもの

B 容器に溝, 肉薄部分または防爆孔を有する
もの

C 保護装置, 例. ヒューズ

Z その他のもの

9/14 ・・・・電解コンデンサの電気的特性の修正,
または補償用構造的組合せ

A 低インピーダンス化に特徴を有するもの

B 無極化に特徴を有するもの

Z その他のもの

9/145 ・液体電解コンデンサ (H01G11/00 が優先)
[6]

9/15 ・固体電解コンデンサ (H01G11/00 が優先)
[6]

100 ・・・・巻回箔電極を用いるもの

9/16 ・整流器または検波器として用いるため特
に適合するもの (H01G9/22 が優先)

9/18 ・自己遮断装置

9/20 ・感光装置

101 ・・・・セル

103 ・・・・電解質

105 ・・・・固体, 例. ポリマーまたはゲル

107 ・・・・液体

107 A溶質

107 B溶媒

107 C添加剤

107 Zその他

109 ・・・・セパレータまたはスペーサ

111 ・・・・光電極

111 A半導体層の材料

111 B半導体層の構造	重層[EDL]コンデンサ;その製造のプロセスまたはその部品製造のプロセス[2013. 01]
111 C半導体層の製造	
111 D導電層, 例. 透明導電層, または集電体	
111 E基板	
111 Zその他	
113 増感剤	
113 A有機色素	
113 B金属錯体	
113 C複数の増感剤の組合せまたは増感剤と他の吸着物質との組合せ	
113 D吸着方法または吸着装置	
113 Zその他	
115 対極	
115 A導電層, 例. 透明導電層または触媒層;集電体	
115 B基板	
115 Zその他	
117 セルの端子またはリード	
119 セル全体またはセル周囲の構造	
121 セルの製造	
201 . . . モジュール	
203 . . . モジュールの構造	
203 Aセル間の導電接続	
203 B・Z型モジュール	
203 C・W型モジュール	
203 Zその他	
205 モジュールの製造	
301 . . . タンデム型	
303 . . . 封止	
303 A材料	
303 B構造	
303 C製造方法	
303 Zその他	
305 . . . 電解液の注入	
307 . . . 光学部材, 例. 反射層, 散乱層または集光部材	
309 . . . 視認性または意匠性	
311 . . . 保護または短絡防止	
313 . . . 評価または試験	
315 . . . 他の電池または他の装置との組合せ	
317 . . . 増感剤を用いないもの	
9/21 . 感温装置[6]	
9/22 . 還元と酸化の組み合わせを用いる装置, 例. Redox 装置, またはソリオン[1, 2013. 01]	
9/26 . 電解コンデンサ, 整流器, 検知器, 開閉装置, 感光装置または感温装置相互の構造的組み合わせ[6]	
9/28 . 電解コンデンサ, 整流器, 検知器, 開閉装置と, このサブクラスに包含されない他の電気構成部品との構造的組み合わせ[6]	
11/00 ハイブリッドコンデンサ, すなわち異なる正と負の電極をもつコンデンサ;電気二	
注	
グループ H01G11/02 は, グループ H01G11/04-H01G11/14 に優先する。[2013. 01]	
11/02	・酸化還元反応を用いるもの, 例. Redox 装置またはソリオン[2013. 01]
11/04	・ハイブリッドコンデンサ[2013. 01]
11/06	・一方の電極の中にイオンが可逆的にドーピングされているもの, 例. リチウムイオンコンデンサ[LIC][2013. 01]
11/08	・構造的な組合せ, 例. ハイブリッドまたは EDL コンデンサと他の電機部品の組み立てまたは連結, 少なくとも 1 つのハイブリッドまたは EDL コンデンサが主たる構成部品であること[2013. 01]
11/10	・複数のハイブリッドまたは EDL コンデンサ, 例. アレイまたはモジュール (ハウジング, ケース, カプセル化またはその取付け H01G11/78) [2013. 01]
11/12	・積層されたハイブリッドまたは EDL コンデンサ[2013. 01]
11/14	・ハイブリッドまたは EDL コンデンサを調整または保護するための装置または方法 (コンデンサに特に適合する緊急保護回路装置, および通常の動作条件から望まない変化を起こした場合に, 自動スイッチが実行される H02H7/16;断路せずに過電流または過電圧を制限するための非常保護回路装置 H02H9/00) [2013. 01]
11/16	・電氣的過負荷に対するもの, 例. ヒューズを含む[2013. 01]
11/18	・熱的過負荷に対するもの, 例. 加熱, 冷却または通風[2013. 01]
11/20	・改善または不純物の除去の方法, 例. 洗浄[2013. 01]
11/22	・電極[2013. 01]
11/24	・電極を構成または組成する材料の構造的な特色に特徴を有するもの, 例. 形態, 表面積または空隙率;そこで用いられる粉末または粒子の構造的な特色に特徴を有するもの[2013. 01]
11/26	・構造に特徴を有するもの, 例. 多層性, 空隙率または表面特性[2013. 01]
11/28	・集電体の上に並べられまたは配置されたもの;電極と集電体の間の層または面, 例. 接着剤[2013. 01]
11/30	・材料に特徴を有するもの[2013. 01]
11/32	・炭素をベースとするもの[2013. 01]
11/34	・炭化または賦活に特徴を有するものの[2013. 01]
11/36	・ナノ構造, 例. ナノファイバー, ナノ

- チューブまたはフラレン[2013.01]
- 11/38 ・・・・カーボンペーストまたはブレンド;
その中の結合剤または接着剤[2013.01]
- 11/40 ・・・・繊維[2013.01]
- 11/42 ・・・・粉末または粒子, 例. それらの組成
[2013.01]
- 11/44 ・・・・それらの原料, 例. 樹脂または石炭
[2013.01]
- 11/46 ・・・・金属酸化物[2013.01]
- 11/48 ・・・・導電性ポリマー[2013.01]
- 11/50 ・・・・リチウムイオンコンデンサに特に適
合したもの, 例. リチウムのドーピングま
たはインターカレーションのためのもの
[2013.01]
- 11/52 ・セパレータ[2013.01]
- 11/54 ・電解質[2013.01]
- 11/56 ・・固体電解質, 例. ゲル; その中の添加物
[2013.01]
- 11/58 ・・液体電解質[2013.01]
- 11/60 ・・・・溶媒に特徴を有するもの[2013.01]
- 11/62 ・・・・溶質に特徴を有するもの, 例. その中
の塩, 陰イオンまたは陽イオン[2013.01]
- 11/64 ・・・・添加剤に特徴を有するもの[2013.01]
- 11/66 ・集電体[2013.01]
- 11/68 ・・材料に特徴を有するもの[2013.01]
- 11/70 ・・構造に特徴を有するもの[2013.01]
- 11/72 ・・複数のまたは積層されたハイブリッド
または EDL コンデンサの一体化に特に適
合したもの[2013.01]
- 11/74 ・端子, 例. 集電体の拡張[2013.01]
- 11/76 ・・複数のまたは積層されたハイブリッドま
たは EDL コンデンサの一体化に特に適
合したもの[2013.01]
- 11/78 ・ケース;ハウジング;カプセル化;取付け
[2013.01]
- 11/80 ・・ガスケット;シーリング[2013.01]
- 11/82 ・・コンデンサ要素のハウジング内への取
付けまたは組立て, 例. 電極の取付け, 集
電体または端子のコンテナ内への取付け
またはカプセル化[2013.01]
- 11/84 ・ハイブリッドまたは EDL コンデンサ, また
はそれらの部品の製造方法[2013.01]
- 11/86 ・・電極に特に適合したもの(電極の製造
のための炭化または賦活 H01G11/34)
[2013.01]
- 13/00 コンデンサの製造に適合した装置;グルー
プ H01G4/00-H01G11/00 に分類されない
コンデンサの製造に特に適合した方法
[2, 2013.01]
- 301 ・リード
- 301 A挿入
- 301 B移送または供給
- 301 C整列または位置決め
- 301 D判別または検査
- 301 Eリード端子の集合体;リードフレーム
- 301 Zその他のもの
- 303 ・・リードの加工
- 303 A樹脂割れ抑制
- 303 Bリード頭部加工
- 303 Cリード表面処理
- 303 D切断
- 303 Zその他のもの
- 305 ・・・・フォーミング
- 305 A折曲げ;切断および折曲げを伴うもの
- 305 Bリードの途中を彎曲
- 305 C矯正
- 305 Zその他のもの
- 307 ・・リードの取付け
- 307 Aステッチによるもの;針で止めるもの
- 307 Bリード旗
- 307 C粉末成形プレスによるもの
- 307 Dろう接
- 307 E半田, 例. 前半田または予備半田
- 307 F溶接
- 307 Zその他のもの
- 311 ・テーピング(電気部品の組立体の製造ま
たは調整 H05K13/00;テーピング電気部品
それ自体 B65D;テーピング電気部品の製
造一般 B65B)
- 311 A着テーピング
- 311 B離テーピング
- 311 Zその他のもの
- 321 ・外装または容器
- 321 A塗装
- 321 Bテープ巻き
- 321 C封口
- 321 D包装
- 321 E樹脂外装
- 321 F被覆
- 321 Gチューブ装着
- 321 H熱収縮チューブ
- 321 Jカラーコーティング;マーキング;表示
- 321 Kモールド成型
- 321 L成型用金型
- 321 Zその他のもの
- 331 ・供給または位置決め
- 331 A供給
- 331 B挿入
- 331 C移送
- 331 D整列または位置決め
- 331 E取出し
- 331 F反転
- 331 Zその他のもの
- 341 ・組立
- 351 ・保持または治具
- 351 A治具

- 351 B吊持または挟持
- 351 Zその他のもの
- 361 ・試験または検査 (表示マーク H01G1/04)
- 361 A選別または自動選別
- 361 B極性判別
- 361 C容量検出
- 361 D漏洩電流検査, 例. 特性劣化試験のためのもの
- 361 E振動試験
- 361 F充放電試験
- 361 G耐圧試験
- 361 Zその他のもの
- 371 ・電解コンデンサ用製造装置 (電解コンデンサの製造方法 H01G9/24)
- 371 A整列または極性判別
- 371 B吊持または保持
- 371 C検査
- 371 Dエージング
- 371 E複数工程
- 371 F化成, 例. 誘電体被膜を形成するもの
- 371 G電極箔, 例. エッチングによる電極箔の形成
- 371 H含浸
- 371 Jエッチング (H01G13/00, 371J 優先)
- 371 Zその他のもの
- 381 ・電気二重層コンデンサ用製造装置 (電気二重層コンデンサの製造方法 H01G11/84, 11/86)
- 391 ・コンデンサの製造方法
- 391 Aエージング;再化成
- 391 B電極塗装
- 391 C蒸着
- 391 Dメタリコン
- 391 E焼成
- 391 Fキャップ製造
- 391 Gスリッティング, 例. アルミ箔のスリッティング
- 391 H切断, 例. セラミックの切断
- 391 J複数工程
- 391 Zその他のもの
- 13/02 ・コンデンサ巻回機[2]
- A 容量調整
- B フィルムまたは箔の加工
- C 巻芯
- D ローラ構造
- E 供給
- F 張力調整
- G ブレーキ
- H 切断
- J のり付け
- K 複数工程のもの
- L 測定または検査
- M 巻取装置の構造
- Z その他のもの
- 301 ・巻取方法
- 301 A巻始め処理
- 301 B巻終り処理
- 301 C取り外し処理
- 301 D同軸で多数巻取るもの
- 301 Zその他のもの
- 13/04 ・乾燥;含浸[2]
- 13/06 ・金属表面を除去するための設備をもつもの[2]
- 15/00 このサブクラスの異なるメイングループのうち, 少なくとも 2 つに包含されるコンデンサまたは他の装置の相互の構造的組合わせ (少なくとも 1 つのハイブリッドコンデンサまたは電気二重層[EDL]コンデンサを主なコンポーネントとして含む H01G11/08) [6, 2013. 01]
- 17/00 複数個のコンデンサ, またはこのサブクラスの異なるメイングループのうち, 少なくとも 2 つに包含される他の装置との構造的組合わせであって, このサブクラスに包含されない他の電気素子を有するもの, 例. RC 組み合わせ[6]